



2016年第十九届中国集成电路制造 年会

尊敬的_____先生/女士，您好！

2016年第十九届中国集成电路制造年会将于2016年09月在厦门召开。

会议通知

2016年是我国“十三五”开局之年，我国集成电路产业迎来了新一轮大发展的机遇。为全面落实《国家集成电路产业发展推进纲要》、探讨我国集成电路产业链协同创新、强化基础、全面提升、平稳快速发展所面临的挑战和发展途径，根据中国半导体行业协会安排，2016年9月19日~22日在福建省厦门市召开“2016中国集成电路产业发展研讨会暨第十九届中国集成电路制造年会”。

中国集成电路产业发展研讨会暨中国集成电路制造年会已成功举办了十八届，每届年会都围绕中国集成电路制造产业链重点内容展开交流研讨活动。年会开成了富有特色的技术交流会、政策推动会、合作信息会，并已在产业界树立了“中国集成电路制造年会”的声誉。本届年会将围绕“十三五”时期我国集成电路产业发展面临的重大转折、机遇与挑战，以“培育发展中国集成电路制造产业链优势”为主题，展开深入的研讨和交流。特邀请国家部委领导、福建省、厦门市地方政府领导、行业著名人士到会致辞；邀请专家学者、企业家、投资人和产业链专家到会发表专题演讲和研究报告；邀请会员单位代表、各省市行业协会的领导和同仁、集成电路产业研究所、高等院校和国内外集成电路设计、制造、封测企业及设备、材料骨干企业的领导和专家相聚一堂，共同探讨培育发展中国集成电路制造产业链优势的路径和方法。会议分为高峰论坛、专题论坛及新闻发布会等活动形式。

会议组织机构

指导单位：工业和信息化部电子信息司

主办单位：中国半导体行业协会

承办单位：中国半导体行业协会集成电路分会 国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟 厦门火炬高新区管委会 厦门市经济和信息化局 厦门信息集团有限公司 厦门高新技术创业中心 江苏省半导体行业协会 上海芯奥会务服务有限公司

协办单位：北京市半导体行业协会 上海市集成电路行业协会 天津市集成电路行业协会 重庆市半导体行业协会 浙江省半导体行业协会 陕西省半导体行业协会 广东省半导体行业协会 深圳市半导体行业协会 大连市半导体行业协会 江苏省集成电路产业技术创新战略联盟 国家集成电路设计无锡产业化基地 南京市集成电路行业协会 苏州市集成电路行业协会 无锡市半导体行业协会

支持单位：《中国电子报》社 《电子工业专用设备》杂志社 《半导体与光伏行业》杂志社

时间安排：2016年9月19日~22日（周一~周四）（19日报到，下午召开中国半导体行业协会集成电路分会理事会）

会议酒店：厦门翔鹭国际大酒店 地址：厦门市湖里区长浩路18号

会议内容

1、高峰论坛：

邀请政府高层领导及国际知名半导体企业、研究机构、产业联盟的负责人，解读《中国集成电路产业“十三五”发展规划》及产业政策，深入解析《国家集成电路产业发展推进纲要》的宏伟目标和指导作用，共商“培育发展中国集成电路制造产业链优势”及产业链协同创新和以应用创新带动产业链整体发展的联动战略，并就半导体产业发展、先进制造与封测技术、装备与材料存在问题与重点突破等方面，以及市场宏观展望、投融资、商业模式的创新

等内容进行交流，共谋产业发展大计。

2、专题论坛：

- (1)、 “十三五”时期我国集成电路产业链发展面临的重大转折，机遇与挑战；
- (2)、 加快产业化进程，推进集成电路制造业和支撑业协同创新，融合配套发展；
- (3)、 融入全球产业链，实现跨越发展；
- (4)、 新形势下产业的自主建设与兼并重组；
- (5)、 做好科技重大专项与国家集成电路产业投资基金的对接；
- (6)、 集成电路制造业发展现状与前景；
- (7)、 先进封装和测试技术产业化进程；
- (8)、 32-28纳米关键制造装备核心关键基础技术的突围；
- (9)、 我国集成电路装备制造业、材料业存在的主要问题及对策。

参会对象：

中央及省市代表以及半导体行业组织（学会、协会）、国内外集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、设计服务、商务咨询及软件供应商、系统厂商、高等院校、研究机构、风险投资机构和有关媒体代表等，参会人数约600人。

会议门票

会务费：(厦门翔鹭国际大酒店，含餐、茶点、纪念品、资料)

A类：1500元人民币/人（不含住宿）

B类：2300元人民币/人（含三晚双人间一个床位，合住）

C类：2900元人民币/人（含三晚单人房或双人房一间，单住）

